

令和5年7月1日



東京都発行の東京ソーシャルボンドへの投資について

シンライ化成株式会社（代表取締役 渋谷朋広、以下当社）は、このたび東京都が発行する「東京ソーシャルボンド」（※）に投資いたしましたことをご知らせいたします。

東京ソーシャルボンド発行による調達資金は「公共施設・インフラの防災対策・老朽化対策」、「産業の振興と雇用の維持・創出」、「一人ひとりの個性や能力を最大限に伸ばすための教育環境の整備」、「介護サービス基盤の整備」などに充当される予定です。

当社は今回の東京ソーシャルボンドへの投資を通じて、サステナブル・リカバリー（持続可能な回復）など社会的な課題を解決する施策への貢献をしていきます。

また、引き続き当社は、E S G領域における投融資を通じて社会的責任を果たして参ります。

※ソーシャルボンドは、社会的課題解決に要する資金を調達するために発行する債券です。